

株主の皆さまへ

第 36 期 報 告 書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

TOWA



 **TOWA株式会社**

■ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、当社第36期報告書（2013年4月1日から2014年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、積極的な金融政策や景気刺激策等により株高・円安が進行したことから、個人消費や企業収益が改善し、景気回復の動きが一段と強まる状況となりました。また、企業収益の伸張を雇用拡大・賃金上昇・消費拡大へとつなげる好循環の実現を狙った追加の経済対策も打ち出され、更なる景気拡大への期待が高まる等、長期間にわたるデフレからの脱却に向けて着実な歩みが感じられる状況にありました。

半導体業界におきましては、半導体メーカー各社の微細化・高機能化への投資負担は更に大きくなり、資金力・技術力のある大手による寡占化が進んでおります。また、製造装置メーカーにおいても、世界のトップ企業同士が経営統合を決定する等、合従連衡や業界再編に向けた動きが活発になってまいりました。半導体の需要としましては、依然としてパソコン向けは低調でありましたが、スマートフォン向けは、ハイエンドモデルに採用されていたアプリケーションプロセッサがミドル／ローエンドモデルにも展開され始めたことにより、引き続き堅調に推移しました。

この様な状況のもと当社グループは、中国市場向け新製品の投入を行う等、「マーケットイン型」の体制構築を積極的に展開してまいりました。また、2013年12月にプライベートショーを開催し、最新設備6機種やナノテク微細加工技術、離型性を高め金型のクリーニング頻度を抑える新素材金型（バンセラ）等の展示を行い、国内外の多くのお客さまに当社の高い技術力を実感していただきました。

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つと考えており、競争力のある製品開発や生産設備への投資、新たな市場への事業展開に係る投資、また財務体質の改善等に必要なる内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。

この方針に基づき、当期につきましては、1株当たり10円の配当とさせていただきます。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

岡田博和

代表取締役会長

飯永和彦

2014年6月

上半期の半導体メーカーやOSAT各社の設備投資には、今ひとつ力強さが見られませんでした。下半期には韓国や台湾地域を中心に投資姿勢が反転し、積極的な動きが出始めてまいりました。

当社グループは、「マーケットイン型」の営業・生産・サービス体制の構築に取り組み、お客さまとの紐帯関係を深めたことに加え、国内外の生産拠点においては、原価低減へのあらゆる方策を検討・実施し、その成果が着実に現れております。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高171億65百万円（前連結会計年度比7億11百万円、4.3%増）、営業利益4億57百万円（前連結会計年度は4億39百万円の損失）、経常利益6億66百万円（前連結会計年度比3百万円、0.6%増）、当期純利益5億68百万円（前連結会計年度比1億23百万円、17.8%減）となりました。

今後も高度なパッケージング技術が必要とされる半導体デバイスにおいて、当社のコンプレッション技術を武器に、モールドイング事業の伸張を図るとともに、車載品や電子部品等の新たな分野へも展開し、安定した収益基盤の構築を進めてまいります。

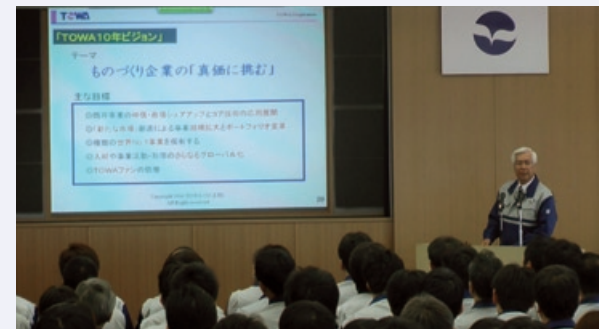
「TOWA10年ビジョン」と「中期（3カ年）経営計画」

当社は「ものづくり企業」であり、これからも「ものづくり企業」であります。当社が考える「ものづくり企業」の真の価値＝「真価」は、単に「ものづくり」の「技術」だけを指すものではありません。自らが事業活動を行い得る新たな市場を生み出す力、つまり「市場を創造する技術力」こそが「ものづくり企業」の「真価」であると考えております。

当社は今日まで、「市場を創造する技術力」を培い、実践し、信念と総和をもって事業活動を遂行してまいりました。その結果、半導体モールドイング事業において世界のリーディングカンパニーとなることができました。

そして今、産業社会が当社に最も求めているものとは正に、今一度当社自らが「創造の力」によって「新たな市場」をこの世に生み出し、既存の高い市場シェアを持つ事業セグメントに「新たな市場」での事業活動を加え、更に大きく社会や産業の発展に貢献していくことであると認識しております。

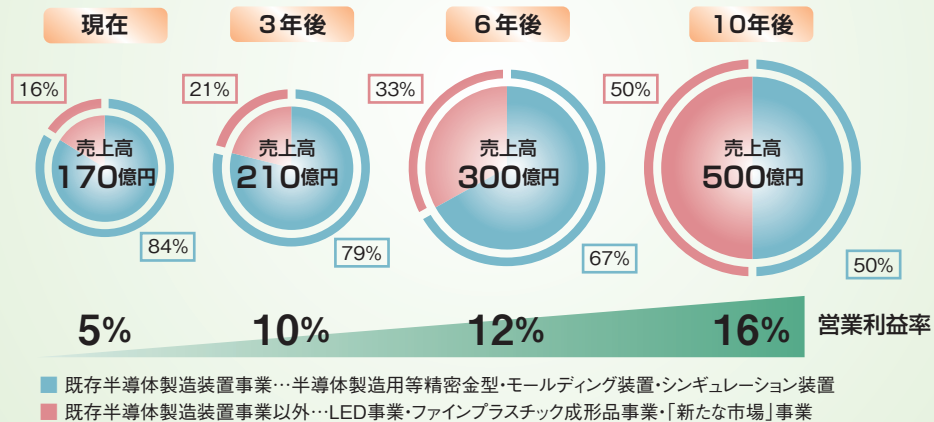
以上のことから当社は、既存事業の伸張とコア技術の応用展開、そして「新たな市場」創造によるポートフォリオ変革等を目指す長期経営ビジョン「TOWA10年ビジョン」を掲げ、その具現化へのマイルストーンとなる諸施策・戦略等を中期（3カ年）経営計画として取り纏めました。



TOWA 10年ビジョン

❖ テーマ 「ものづくり企業の真価に挑む」

- ▶ 既存事業の伸張・市場シェアアップとコア技術の応用展開
- ▶ 「新たな市場」創造による事業規模拡大とポートフォリオ変革
- ▶ 複数の世界No.1事業を保有する
- ▶ 人材や事業活動・形態のさらなるグローバル化
- ▶ TOWAファンの倍増



中期(3カ年)経営計画

❖ 基本方針 「市場を創造する」ものづくりの実践

「成長戦略」と「基盤強化」の2つのアプローチをベースに、各戦略や方策に取り組みます。
 主な内容は以下の通りであります。

成長戦略

- ▶ コンプレッション技術によるモールドング事業の伸張・他分野への展開
- ▶ シンギュレーション事業の市場シェアアップ
- ▶ 「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

基盤強化

- ▶ 営業活動網・活動形態の再構築
- ▶ 高効率生産体制の追求
- ▶ グローバルリーダーの育成

中期(3カ年)数値計画

(単位:億円)

項目	期別	2015年3月期 (計画)	2016年3月期 (計画)	2017年3月期 (計画)
売上高	合計	180	190	210
	半導体製造装置事業	155	160	165
	LED事業	11	12	15
	ファインプラスチック成形品事業	12	13	15
営業利益	合計	10	15	21
	「新たな市場」事業	2	5	15
	常利	9	14	20
	当期純利	8	13	14

TOPICS トピックス

プライベートショー2013を開催

2013年12月から2014年1月の約2ヵ月間にわたり、本社工場にて、プライベートショーを開催し、国内外から多くのお客さまにご来場いただきました。

“真価へ導く、知の技術”をテーマとし、当社のコア技術を用いた新製品の紹介や新しいプロセスの提案等を行った結果、お客さまから今後のパッケージ開発や生産効率向上への取り組みに繋がるとの高い評価をいただくことができました。



第5回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞

2013年10月、経済産業省・国土交通省・厚生労働省・文部科学省の4省が連携し、隔年に開催している「第5回ものづくり日本大賞」近畿ブロック表彰式が行われ、当社独自技術であるコンプレッション方式のモールドング装置 (PMCシリーズ) が、製品・技術開発部門で「優秀賞」を受賞しました。

「樹脂有効使用率100%、樹脂流動レスを実現した半導体用圧縮成形樹脂封止装置の開発」というコンセプト等が高く評価されました。



今後も産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」を創成することにより、新たな事業分野にも果敢に挑戦し、ものづくり企業の真価に挑んでまいります。

グローバルニッチトップ企業 100選に選出

経済産業省が認定する「グローバルニッチトップ (GNT) 企業100選」に選出され、2014年3月に経済産業省において表彰されました。

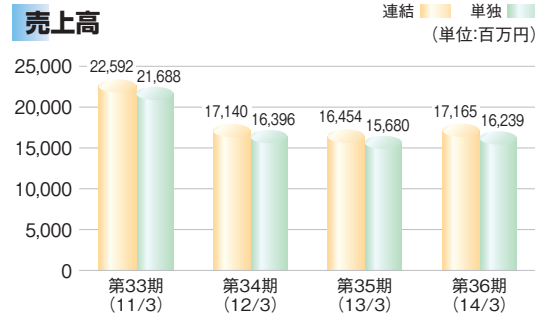
「GNT企業100選」は、国際市場の開拓に取り組んでいる企業のうち、ニッチ分野において高いシェアを確保し、良好な経営を実践している企業を顕彰するものです。

当社が開発した「半導体樹脂封止用の金型 & 全自動装置」の独自性や市場性等が高く評価され、機械・加工部門で選出されました。

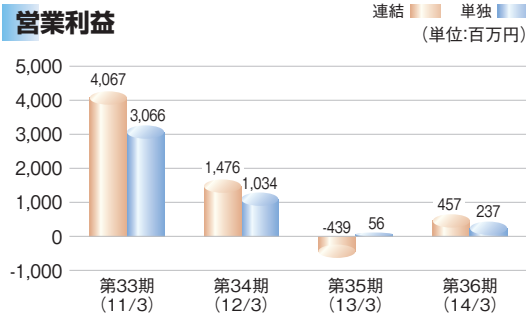


業績の推移

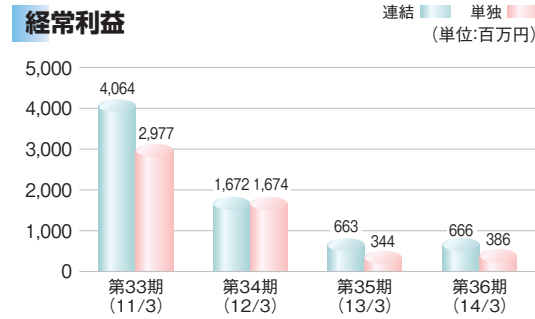
売上高



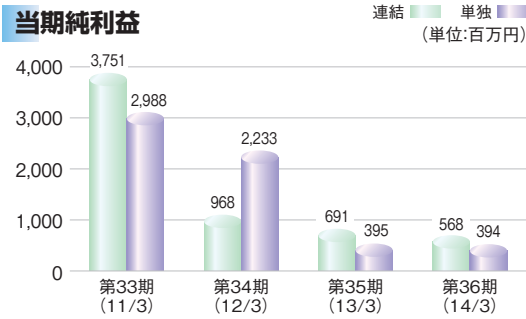
営業利益



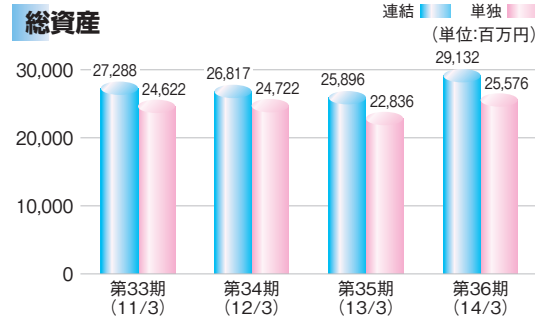
経常利益



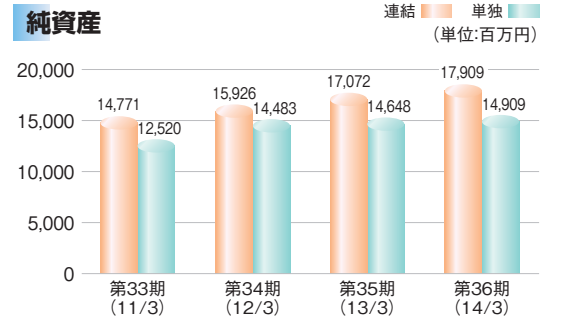
当期純利益



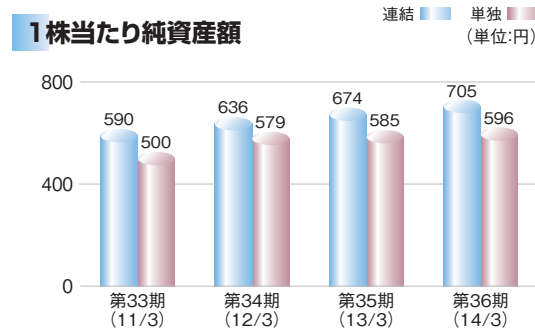
総資産



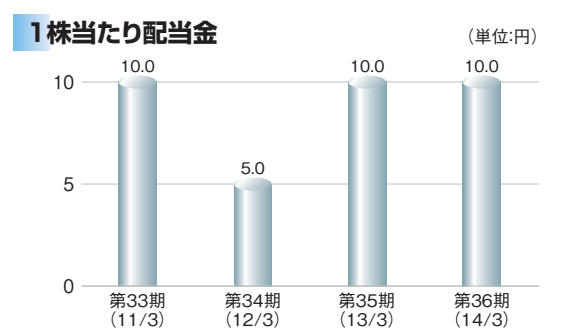
純資産



1株当たり純資産額

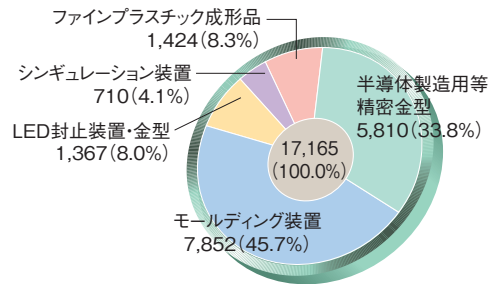


1株当たり配当金

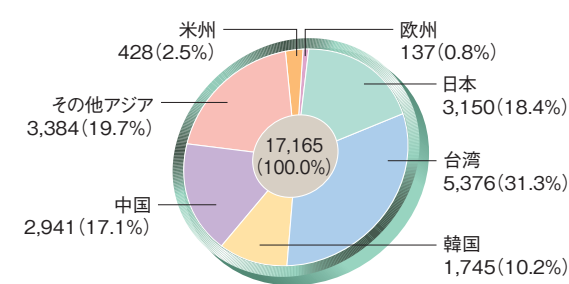


[セグメント別連結売上高 (第36期)]

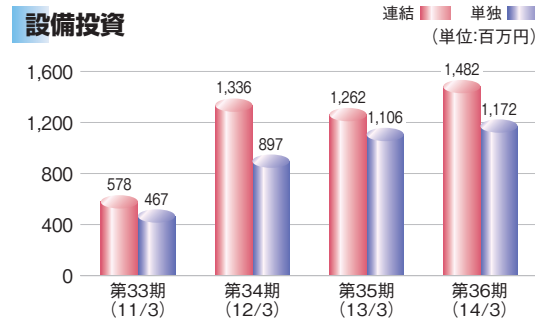
製品別 (単位:百万円)



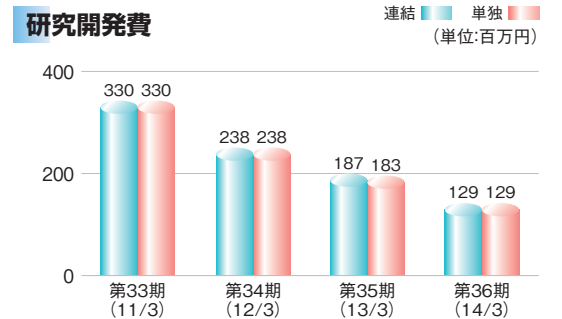
地域別 (単位:百万円)



設備投資



研究開発費



決算概要

連結貸借対照表 (2014年3月31日現在)

科目	金額
【資産の部】	
流動資産	15,713
現金および預金	5,921
受取手形および売掛金	6,249
たな卸資産	3,175
その他	368
固定資産	13,419
有形固定資産	10,622
建物および構築物	3,583
土地	4,190
その他	2,849
無形固定資産	531
投資その他の資産	2,265
資産合計	29,132

(注) 当期の連結子会社は15社、持分法適用会社は1社であります。

連結損益計算書

(2013年4月1日から2014年3月31日まで) (単位: 百万円)

科目	金額
売上高	17,165
売上原価	12,622
売上総利益	4,542
販売費および一般管理費	4,084
営業利益	457
営業外収益	312
営業外費用	103
経常利益	666
特別利益	13
特別損失	17
税金等調整前当期純利益	662
法人税・住民税および事業税	106
法人税等調整額	△ 30
少数株主損益調整前当期純利益	586
少数株主利益	17
当期純利益	568

(単位: 百万円)

科目	金額
【負債および純資産の部】	
流動負債	7,060
支払手形および買掛金	2,582
短期借入金	1,601
その他	2,877
固定負債	4,162
長期借入金	2,953
その他	1,209
負債合計	11,222
株主資本	16,594
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	7,208
自己株式	△ 8
その他の包括利益累計額	1,057
その他有価証券評価差額金	509
為替換算調整勘定	511
退職給付に係る調整累計額	35
少数株主持分	257
純資産合計	17,909
負債・純資産合計	29,132

連結キャッシュ・フロー計算書

(2013年4月1日から2014年3月31日まで) (単位: 百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	935
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,553
財務活動によるキャッシュ・フロー	819
現金および現金同等物に係る換算差額	64
現金および現金同等物の増減額	266
現金および現金同等物の期首残高	5,266
現金および現金同等物の期末残高	5,533

連結株主資本等変動計算書 (2013年4月1日から2014年3月31日まで)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2013年4月1日 期首残高	8,932	462	6,890	△ 8	16,276
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 250		△ 250
当期純利益			568		568
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	318	△ 0	317
2014年3月31日 期末残高	8,932	462	7,208	△ 8	16,594

	その他の包括利益累計額				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2013年4月1日 期首残高	392	202	—	595	200	17,072
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△ 250
当期純利益						568
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	117	309	35	462	57	519
連結会計年度中の変動額合計	117	309	35	462	57	837
2014年3月31日 期末残高	509	511	35	1,057	257	17,909

会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,932,627,777円		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250 (代表)		
従業員数	431名		
役員	代表取締役会長	坂東和彦	
(2014年6月27日現在)	代表取締役社長	岡田博和	
	専務取締役	天川剛	
	常務取締役	小西久二	
	常務取締役	福富誠	
	取締役執行役員	浦上浩	
	取締役執行役員	田村吉住	
	取締役	桑木肇	
	執行役員	石田耕一	
	執行役員	岸本昌利	
	常勤監査役	小林久芳	
	監査役	杉山公大	
	監査役	和氣大輔	
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp		
上場取引所	東京証券取引所市場第一部		

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年		
定時株主総会	毎年6月		
基準日	株主総会権利行使および期末配当	3月31日	
	中間配当	9月30日	
単元株式数	100株		
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社		
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部		
郵便物の郵送先及び 電話お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)		
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)		
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむをえない事由により電子公告を することができない場合は、日本経済新 聞に掲載します。 公告掲載URL http://www.towajapan.co.jp		

株式の状況 (2014年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,021,832株
●株主数	8,119名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	4,350千株	17.39%
有限会社ケイビー恒産	2,000	8.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,586	6.34
坂東和彦	1,555	6.22
株式会社京都銀行	699	2.80
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800	609	2.44
BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG - JASDEC SECURITIES	550	2.20
山田矩規子	510	2.04
有限会社ケイビークノ	500	2.00
HSBC - FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO LTD	470	1.88

(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式 (10,633株) を控除して計算しております。

TOWAグループ (2014年3月31日現在)

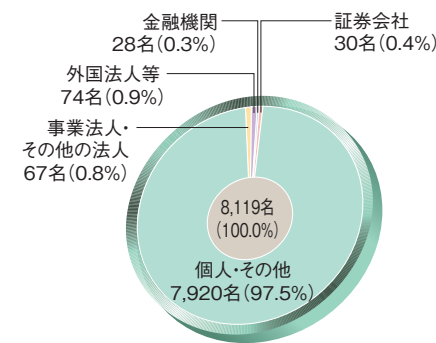
国内

TOWA株式会社
本社・工場
京都東事業所
坂東記念研究所
九州事業所
東京営業所
株式会社バンディック
TOWATEC 株式会社
株式会社サーク

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp. (フィリピン)
TOWA USA Corporation (米国)
TOWA Europe B.V. (オランダ)
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
巨東精技股份有限公司 (台湾)
TOWA韓国株式会社 (韓国)
株式会社東進 (韓国)

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布

